U.D.C. 621.318.134-477 : [546.34+546.72]-31 538.2 : 621.762.222 : 621.926.086

# Li系フェライトメモリコアの磁気特性に及ぼす 粉体処理効果

Effect of Powder Treatment on Magnetic Properties of Lithium Ferrite Cores

> 田嶋善造\*上原保彦\*小田原弘造\* Zenzô Tajima Yasuhiko Uehara Kôzô Odawara

### 要 旨

Li 系フェライトメモリコアの製造過程中,特に仮焼後の粉砕効果が焼結性ならびに磁気特性に与える影響について検討した結果,次の結論を得た。(1)同一密度の焼結体の結晶粒を比較すると,短時間粉砕のほうが,長時間粉砕よりも結晶粒は大きく,その分布はせまい。(2)メモリコアのパルス特性は,短時間粉砕のほうが比較的低い駆動磁場において最大角形を有し,長時間粉砕のほうが比較的高い駆動磁場において最大角形を有する。(3)この関係は磁気特性についても成り立つ。これは焼結とともに,焼結体の空孔 (pore)の大きさとその間隔が変化する過程が粉砕時間によって異なることに起因する。すなわち上記過程が抗磁力  $H_e$ ならびにその分散  $\sigma$ を決め,この両者が角形  $R_s$ を定める。



言



装置はよりより入谷重化,高速化ビララある。ビルハウモ, モルウ に使用されるフェライトメモリコアに対しても,高い性能,生産性な らびに信頼性が要求されている。現在,世の中で使用されているフ ェライトメモリコアは,その温度特性から,MnMg系フェライトで 代表される一般的なものと,Li系フェライトで代表される広温度域 のものとがある。前者のMnMg系のフェライトメモリコアの動作 範囲は温度補償を行なっても0~50℃が限度であろう。それゆえ,最 近では,キューリ温度の高い後者のLi系のフェライトメモリコアが 広温度域メモリコアとして広く使用されるようになってきている。

1. 緒

後者の広温度域メモリコアとしては、16ミルメモリコア HFC 182, 18ミルメモリコア HFC 280, 20ミルメモリコア HFC 258, 30ミル メモリコア HFC 382 などがあり、特性例を示したのが図1である。 一般に、フェライトメモリコアは粉末冶金的手法で製造されてい るため、粉体処理条件の選定が組成の選定とならんで最も重要であ る。粉体処理条件の中で特に製品の特性に影響を与えるのは、粉砕、 仮焼の条件である。本論文では、特に Li 系フェライトメモリコア製 造過程中の仮焼後の粉砕条件が、焼結性、磁気特性などに及ぼす影 響について調べ、若干の考察を加えてみた。

### 2. 実 験 方 法

2.1 試 料

実験に使用したLi系フェライトは,原料粉末を湿式混合後,空気 中で940℃で2時間仮焼し,その仮焼粉体を振動ボールミルにて1, 5,20時間粉砕し,3種のフェライト粉体を得た。各フェライト粉 体は,成形を行ないやすくするため結合剤としてPVA 2.0%を添加 し,噴霧乾燥法によって造粒した。

焼結体密度の測定および結晶組織の観察用の試料としては,外径 8¢,厚さ約4mmのペレット状の成形体を作成した。パルス特性, B-H特性測定用の試料としては,18ミルメモリコアと同じく,外 径0.5¢,内径0.35¢,厚さ0.15mmのトロイダル成形体を作成した。 成形体の密度はすべて3.0g/ccに統一した。この場合粉体の種類に 関係なく成形圧は,ほぼ同一(約4t/cm<sup>2</sup>)であるので成形条件が焼 結速度に及ぼす影響は無視できるものと考えられる。 \* 日立製作所茂原工場

	111 1112	- 1	- 10	- 5
D.R. $\left(\equiv \frac{I_d}{I_d}\right) = 0.61$	H F C 182	30	120	30
$(I_f)$	H F C 280	100	500	100
	H F C 258	50	500	50
	H F C 382	100	800	100

図1 広温度域 Li系フェライトメモリコアの電流特性

### 2.2 焼 結

各成形体を白金メッシュボートにのせ,酸素気流中にて1,000~ 1,200℃の温度範囲で所定の時間加熱した。昇温,冷却速度は約70 ℃/min である。

2.3 測 定

粉体粒子は電子顕微鏡写真で観察した。焼結体の密度は,焼結体 の寸法をマイクロメータで,重量を化学天秤(てんびん)で測定して 求めた。焼結体の結晶組織は,焼結体の自由表面をレプリカ法電子 顕微鏡写真にとって観察した。

メモリコアのパルス特性は、CTC 社製の Programmed Pulse Generator を用いて、図2に示すブロックダイヤグラムを組んで測 定した。パルス列は図3に示したとおりで、ステップ6で無妨害出力

 $UV_1$ を,ステップ4で妨害出力 $DV_1$ を,ステップ1で雑音出力 $DV_z$ を読み出した。図4はパルス波形に関する定義を示したものである が,ここでは $t_r = t_f = 100$  ns,  $t_w = 500$  ns,  $I_d = 0.61$   $I_f$  の条件で測定 を行なった。図5は出力波形を,図6は  $I_d$ ,  $I_f$  を変えた場合の電流 特性を示したものである。図6において,駆動電流  $I_f$ を増加させて いった場合, $DV_z$ が急激に大きくなる限界電流  $I_{fb}$  の90% を $I_f$ \* と

— 35 —

136昭和45年2月

日

立 評

論

第52巻第2号







20 時 間 粉 砕

粉体粒子の電子顕微鏡写真 义 7  $(\times 10,000 \times \frac{1}{2})$ 

-

図 8 焼結過程における形態変化

し、この電流を各メモリコアの試験電流とした。

上記パルス特性の測定と並行して B-H 特性を測定した。測定器 としてはシグマ電気製の 10 kHz B-H スコープを用い, 測定に際 しては一定温度の空気を試料に吹きつけて駆動線の発熱による温度 上昇を防いだ。

### 3. 実験結果および検討

### 3.1 粉体特性

焼結に重要な影響を及ぼす粉体の性状としては, 粒度と表面活性 度の二つがある。 粉砕という機械的操作によって粒度が小さくな り,表面活性度が変化し、それが焼結を含む固相反応に変化を及ぼ すことはよく知られている(1)。

図7は940℃で2時間仮焼後, 1, 5, 20時間粉砕して得られた粉 体粒子の電子顕微鏡写真である。1時間粉砕した粉体では微粒子が



#### 3.2 焼 結

焼結は現象的には粒子間げきの空孔(pore)の消滅過程として観察 されるが、その過程は一般には3段階にわけて考えることができ る(3)(4)。まず第1の初期段階では空孔は連続的に連なって存在し, 焼結が進むと粒子接触点におけるネックが成長する(図8(b))。焼 結体の大きな収縮と緻(ち)密化はこの段階で起こる。中間段階では 粒子の成長も始まりかける。空孔は粒子間の稜(りょう)に沿って円 筒状に連なり(図8(c)),これが単調に収縮し緻密化が進む。最終 段階では結晶成長が起こるが,(i)孤立した空孔が粒界の角に残る 場合(図8(d)),(ii) 急速な成長のもとで空孔が粒子内にとり残さ れる場合の二つがある。(i)では空孔は粒界を通って外界に逃げる ため緻密化は比較的速く進むが、(ii)では空孔は結晶粒内を拡散す る過程がはいるため緻密化は遅くなる。 このような焼結過程を調べるには、一般には、成形体の加熱に伴

ほとんど生成していないが,20時間粉砕した粉体では微粒子が多量 に生成している。これは振動ボールミルの粉砕が表面粉砕を通して 行なわれていることを示している(2)。また 20 時間粉砕した粉体では 粒子表面の粗度(roughness)が著しく増大している様子がよくわか る。これらの粉体の性状の違いは, 焼結反応に大きな影響を及ぼす ことが予想される。

う収縮率および密度の変化の測定 4.6 200 3 4.4 と,得られた焼結体の結晶組織の ,150°C (b) 20 4.2 観察とを併用することが有効な手 施結体密度 第14.0 第13.8 (a) 100°C 段である。まず粉砕時間を変えた 1.050°C 各試料の初期段階における焼結過 3.6 1時間粉砕 程を調べてみた。実験は通常の熱 30 100 10 膨張計の原理を用いた装置を自製 時間 (min) 4.6 1,200°C し, その装置で成形棒の等速昇温 **2** 4.4 .150°C 100°C による収縮率の変化を求めた。結 bb 4.2 税結体密度 3.8 050°C 果は図9に示すように,長時間粉 砕の試料では, 短時間粉砕の試料 に比べて, 焼結に伴う収縮開始温 3.6 5時間粉砕 度が若干高温側にずれているが, 30 100 10 3 時間 (min) 高温側における収縮率は著しく大 4.6+ 1.200°C きい(5)。このような長時間粉砕の (j) 4.4 مع 試料の高温側, すなわち焼結の中 4.2 预結体密度 3.8 間段階および最終段階における著 (d) 3.8 しい収縮は, 焼結温度をパラメー 3.6 タとして焼結時間と焼結体密度と 20時間粉砕 30 100 10 の関係を求めた図10の結果にいっ 時間 (min) そうよく現われている。すなわち 図10 粉砕時間を変えた 試料の焼結時間と焼結 図10は各試料につきペレット状 体密度の関係 の成形体を温度と時間を変えて焼





(a) 1時間粉砕 1,150℃×3分焼結 焼結体密度 4.16 g/cc

(d) 20時間粉砕 1,050℃×3分焼結 焼結体密度 4.06 g/cc



(b) 1時間粉砕 1,150℃×30分焼結 焼結体密度 4.36 g/cc

(e) 20時間粉砕 1,050℃×30分焼結 焼結体密度 4.35 g/cc





結した場合の結果であるが,同一密度の焼結体を得るための焼結温 度は20時間粉砕の試料は1時間粉砕の試料と比較して著しく低く, 約100℃の差が生じている。 このことは、粉砕によって焼結が著 しく促進されていることを示している。

緻密化の動力学から, 焼結体密度 ρ と焼結時間 t とは

ここに, A: 定数

の関係で近似できる(6)。図10はこの関係をほぼ満足しているが,密 度4.5g/ccの近辺で直線にクニックが現われる。このクニックの現 われる過程は、前述の焼結の最終段階における(i)(ii)に相当し、 密度 4.5g/cc 以下ではおもに(i)の過程で,密度 4.5g/cc 以上では おもに(ii)の過程で緻密化が進むことによるものと考察される。一 方,後述のようにメモリコアとしてほぼ満足なパルス特性が得られ る焼結体の密度の領域としては、ほぼ 4.1 g/cc から 4.5 g/cc の範囲 であることから,その領域における焼結体の結晶組織を調べてみた。 1時間粉砕の試料から焼結条件を変えた三つの焼結体(図10のa, b, c) を, 20 時間粉砕の試料から焼結条件を変えた三つの焼結体(図 10のd, e, f)を選び、それぞれの焼結体の自由表面の結晶組織をレ プリカ法電子顕微鏡写真にとり,図11に示した。この写真から次の 結論が得られた。(1)ほぼ同一の密度の焼結体で結晶粒の大きさを 比較すると、1時間粉砕の試料のほうが20時間粉砕の試料よりも結 晶粒は大きい。すなわち短時間粉砕の試料ほど同一密度の焼結体の 結晶粒は大きい。(2)結晶粒の分布を比較すると,20時間粉砕の試料 では微小結晶粒と巨大結晶粒の共存するいわゆる duplex structure が現われており、粒度分布は広いが、1時間粉砕の試料ではそれが なく分布は狭い。

このような結晶組織の差異はメモリコアのパルス特性に大きな差 このように、 $\frac{UV_1}{r;h}$ ,  $t_r \frac{DV_z}{r;h}$ をD.F.の関数として扱えば、寸法、 異をもたらすことが予想される。以下これについて述べる。 測定条件によらず、材質のみに帰因する特性評価が可能となる。 3.3 パルス特性 D.F.を横軸に,  $\frac{UV_1}{r \cdot h}$ ,  $t_r \frac{DV_z}{r \cdot h}$ を縦軸に描いたいわゆる材質設計 メモリコアのパルス特性の評価方法にはいろいろあるが、われわ 図(7)において、メモリコアとしては、所定のD.F.において出力 れがここで調べたいのは,粉砕時間の差がメモリコアのパルス特性  $\left(\frac{UV_1}{r_ih}\right)$ が大きく, 雑音 $\left(t_r \frac{DV_z}{r_ih}\right)$ が小さく, すなわち出力対雑音比 にどのような影響を与えるかについてである。そのため,ほかの変動 パラメータである測定条件およびメモリコアの寸法を規格化した評 S/N が大きいことが望まれる。

— 37 —

(c) 1時間粉砕	(f) 20時間粉砕
1,150℃×100分焼結	1,050℃×100 分焼結
焼結体密度 4.46 g/cc	燒結体密度 4.46 g/cc

図11 焼結体自由表面の電子顕微鏡写真 (×5,000×1)

価方法をとる必要がある。そこで次のような評価方法を採用した。 メモリコアの内径をDiとすると、試験電流If\*が流れたときメモ リコアに生ずる駆動磁場 Hmは

で表わされる。それゆえ同一試験電流 L\*において,内径 Di が大 きいほどメモリコア内の駆動磁場 Hm は小さくなる。メモリコアの 出力 UV1は駆動磁場 Hmの強さとコアの磁束に比例すると考えて 良いが,若干の計算結果によれば,出力 UV1は次式で表わされる(7)。

 $\frac{UV_1}{r_i h} = F\left(\frac{I_f^*}{\pi D_i}, S_w, \rho\right) \dots (3)$ ここに、 $r_i$ : コアの内半径 (=1/2 $D_i$ ) (mil) h: コ ア の 厚 さ (mil)  $S_w$ : スイッチング係数 (Oe・ $\mu$ s) *ρ*: スイッチング抵抗 (Ω) ここで Su, pは材質に帰因する値である。 それゆえ寸法について の効果を除くためには $\frac{UV_1}{r_ih}$ を $\frac{I_i^*}{\pi D_i}$ の関数として扱えばよい。 駆 動磁場  $H_m$  に相当する  $\frac{I_f^*}{\pi D_i}$  を以下 drive factor (= D.F.) と略称す るの。妨害出力 DV\_についても同様に扱うことができるが、DV\_は 測定の際の立上り時間 t,にも依存し、次式で表わされる。

138昭和45年2月

日

57. 評 論

第52巻第2号



る。D.F.の増加に伴って全体的に S/N の向上がみられることは当 然であるが、特長的なことは、粉砕時間により S/N は D.F. に対し てそれぞれ最大値を有することである。すなわち1時間粉砕のメモ リコアは D.F. が 40 mA/mil 付近で S/N は最大となり, 5 時間粉砕 のメモリコアは D.F. が 70 mA/mil 付近で S/N は最大となる。 20 時間粉砕のメモリコアではさらに高い D.F. 域で S/N が最大値を とる傾向を示す。すなわち粉砕が進むと S/N の最大値を与える駆動 磁場(D.F.)が高いほうにずれていく。このような変化は、結晶組織 から一応予想されることではあるが、それを次節において基本的な 磁気特性を検討することによって考察を行なってみる。

めると、図13のようになる。ここでB-H曲線における最大磁束 密度  $B_m$ , 残留磁束密度  $B_r$ , 抗磁力  $H_c$ , 角形  $R_s \left( \equiv \frac{B - \frac{1}{2}H_m}{B_m} \right)$ の定 義を図14に示した。

前節でパルス特性を測定した各メモリコアについて,駆動磁場Hm を 6.3 Oe から 18.9 Oe まで広範囲に変えて B-H 特性を測定し,  $H_{c}, B_{m}, R_{s}$ を求めた。図 15 は駆動磁場  $H_{m}$ をパラメータとした場合 の焼結温度と $H_c$ ,  $B_m$ ,  $R_s$ の関係を示したものである。図15によれば、 駆動磁場 H<sub>m</sub> が大きい条件, すなわち B-H 曲線においてメーンル ープに近い状態で得られる H<sub>e</sub>は, 焼結温度が高くなるほど小さく なる。しかし、実用動作条件ではメモリコアはマイナループを用 いることが多く、その場合の He は焼結温度に対して最大値を持っ ていることがわかる。そして、ちょうど He が最大値を示す焼結温 度近辺において Rs も最大値を示している。さらに興味深い事実は, 図15において最大H。ならびに最大R。を結ぶ点線によって示され る軌跡は、粉砕時間によって変わっていることである。すなわち



#### 4. 考 察

以上, Li系フェライトメモリコア製造工程における粉砕条件が, 成形体の焼結性, 焼結体の結晶組織, 磁気特性などに及ぼす影響に ついて述べたが、これらの関係について若干の考察を加える。

図15に示したように、マイナループの抗磁力Hcならびに角形比 R。がある焼結温度に対して最大値を示し、しかもその最大値の位置 が粉砕条件によって異なるということから,H。の分散が粉砕条件な らびに焼結温度によって異なることが予想される。

ここで H<sub>c</sub>および H<sub>c</sub>の分散 σについて若干定量的に論ずるに は、その要因として、①磁気異方性、磁歪(じわい)、②空孔、析出 物, 夾雑物 (きょうざつぶつ), 転位, 結晶粒界の効果, ③ イオン の濃度こう配などを考える必要がある。そのほか、磁区間の相互作 用およびメモリコア内での磁場の不均一による分散というやっかい な問題があるが,粉砕条件の効果を論ずる場合は上記要因中,主とし て②の空孔,析出物,夾雑物,転位,結晶粒界のみを考慮すればよい。 以下,マイナループのH。とその分散 o の効果を調べるために, Li系フェライト多結晶体の磁化状態を考えてみる。Li系フェライト

$R_s$ については、20時間粉砕のメモリコアでは焼結温度が低く、 $H_m$
が大きいほど R。の最大値は大きいが,1時間粉砕のメモリコアで
は焼結温度が高く, Hm が小さいほど Rs の最大値は大きい。このこ
とは、S/Nの最大値を示す D.F.の値が粉砕時間によって異なって
くるという前節で述べた結果とよく合致している。



の磁化容易軸 〈111〉 は多結晶体では等方的に分布しているはずで, かつ 〈111〉 方向のスイッチ限界磁場 H。」の大きさはガウス分布に 従うものと考える。外部磁場Hmと〈111〉方向すなわち磁壁面のな す角をθとするとスイッチするためには,

でなければならない。したがって,スイッチする立体角は図16から,

あるいは,

となる。ここで Ho,, がガウス分布に従うため、マイナループの Ho, 分布は, 正規化しない形で表わすと,



磁気的にみた結晶空孔と磁気特性のモデル図 図 19

となり、図17では斜線部分で示される。これを模式的に述べると、 図17のように低温焼結で(I)のようなHo,分布をしている試料に 対し, Hm なる磁場を加えると、マイナループは斜線部分がスイッ チして Ho, 期待値として Ho, (1)となる。 いま問題にしている領域 は、じゅうぶんな緻密化が完了する前の段階であるため、焼結温度 を上げると Hon の減少よりも急激に Hon の分散 のが減少する。 そ のため Hon は(II)のような分布となり、マイナループは図 17 の点 印部分がスイッチして  $H_{o_{II}}$ の期待値  $H_{o_{II}}(I)$ は  $H_{o_{II}}(I)$ よりも大き くなる。逆にいえばマイナループの Hcの焼結温度による変化は, まず Ho, の分散 σ が減少し、ついで Ho, の期待値の減少が支配的 になる過程を示すものと考えられる。したがってマイナループの Hc 最大点は Hou の分散の急速な減少がほぼ終了したところに相当 する。いいかえれば、この条件は Η₀"/σ が最大になる条件とも等価 で,ほぼ Rsの最大点とも一致している。

これらのことは、H<sub>e</sub>, R<sub>s</sub> が密度依存量ではなく結晶組織依存量で あることを示している。

本実験で使用した焼結体は図11の電子顕微鏡写真およびX線分 析の結果から析出, 夾雑物などは見出されなかったので, 結晶組織 による H<sub>c</sub>, R<sub>s</sub> などの差は焼結体中の空孔の大きさと分布などの差 に起因すると考えてよさそうである。

一般に空孔が存在すると、その近くを磁壁が通過したほうが静磁 エネルギーが小さくなる<sup>(8)</sup>。そしてわずかな空孔でも、それによる 静磁エネルギーの減少は大きく、試料の外形とは無関係に内部の空 孔の位置によって磁壁分布が決められてしまう場合が多いとされて

ング限界磁場 H。は圧力と、磁壁の表面張力のつりあいから次式で 表わされる(8)。

しかし, 磁壁移動に対する束縛力が弱いときは, 磁壁が空孔を離れ やすく、このときは H。は次式で示されるようになる(8)。

ただし、 $\sigma_{\omega}$ は磁壁エネルギー、 $I_s$ は飽和磁化、rは空孔半径(m)、 lは空孔間距離(m)を示す。ここで両式のH。を等しいとおくと,空 孔間距離1と空孔半径rが次式の関係をもつ状態が存在する。

本実験で使用した試料の σω は約 2×10<sup>-4</sup> J/m<sup>2</sup>, Is は約 0.3 wb/m<sup>2</sup> であり、オーダエスティメーションのために上式に代入すると,

 $l = 6.8 \times 10^7 r^2 \dots (12)$ となる。この *l* と *r* の関係は、これを境にして、*l*≦6.8×10<sup>7</sup> r<sup>2</sup> では 磁壁が空孔で束縛されて磁壁は不連続膨張により成長する。この領 域を束縛域ということにする。一方 l≥6.8×10<sup>7</sup>r<sup>2</sup> では磁壁が空孔で 強く束縛されておらず,磁壁はあまり湾曲せずに束縛からのがれる。 これを非束縛域ということにする。これらの関係をモデル図で示し たものが図19である。

図19において非束縛域の等H。線は同時に等密度線にもなって おり,A2とB1の状態は密度が等しい。さらに図19のS点から短時 間粉砕試料と長時間粉砕試料の焼結を開始すると,結晶の電子顕微 鏡写真から明らかなように同一密度の状態では前者のほうが結晶粒 が大きい。したがって後者よりも空孔間隔しは大きいと考えてよい。

以上により長時間粉砕試料が焼結により、図19の1とアの関係が
SA1A2Aのように変化するならば、短時間粉砕試料は焼結に伴い
SB1Bのように変化するはずである。さらに図19を吟味すると焼結
が進み, l=6.8×10 <sup>7</sup> r <sup>2</sup> で決まる OA <sub>1</sub> B <sub>1</sub> 状態を通り越すと H <sub>c</sub> は急激
に減少することがわかる。これは OA1 B1 状態 が 最大角形の状態に
対応していることを意味している。短時間粉砕試料では状態 B <sub>1</sub> が,

\_\_\_\_\_ 39 \_\_\_\_\_

論

長時間粉砕試料では状態 A<sub>1</sub>が,それぞれ最大角形の状態に対応し, 明らかに前者(B<sub>1</sub>)のほうが高密度のはずで,実験結果とよく一致し ている。

### 5. 結 言

Li系フェライトメモリコアの製造過程中,特に仮焼後の粉砕効果 が焼結性ならびに磁気特性に与える影響について検討した結果,次 の結論を得た。

- (1) 粉砕は表面粉砕で進行し,長時間粉砕の粉体では,微粒子の生成および粒子表面粗度の増大が著しい。
- (2) 長時間粉砕した粉体を成形した試料の焼結速度は,短時間 粉砕した粉体を成形した試料の焼結速度よりもかなり 速い。
- (3) 同一密度の焼結体の結晶粒を比較すると,短時間粉砕のほうが,長時間粉砕よりも結晶粒は大きく,その分布は狭い。
- (4) メモリコアのパルス特性は、短時間粉砕のほうが比較的低

い駆動磁場において最大角形を有し,長時間粉砕のほうが 比較的高い駆動磁場において最大角形を有する。

(5) (4)のパルス特性上の関係は,磁気特性についても成り立つ。これは焼結とともに,焼結体の空孔の大きさとその間隔が変化する過程が粉砕時間によって異なることに起因する。すなわち上記過程が抗磁力 H<sub>e</sub>ならびにその分散 σ を決め,この両者が角形比 R<sub>s</sub>を定める。

### 参考文献

- (1) 久保: 化学と工業, 16, 901 (1963)
- (2) 上原: 粉体工学, 6, [11] (1969)
- (3) R. L. Cable: J. Appl. Phys., 32, 787 (1961)
- (4) 桐山, 金丸: 応物, 34, 297 (1965)
- (5) 上原,田嶋: 第8回窯業基礎討論会講演要旨集 p.163 (1969)
- (6) 久保ほか: 粉体の理論と応用, 689 (昭37 丸善)
- (7) 小田原,中島: 電気通信学会電子回路部品・材料研究会資料,資料番号 CPM 67-25 (1967-08)
- (8) 近角, 強磁性体の物理(昭34 裳華房)



すように数十本の燃料棒1を締付具2により束ねて構成している。

ところで、この締付具2の保持は燃料要素中央の燃料棒によって なされ、その取付け部分はセグメントの連結プラグが利用されるが、 セグメントをつないで燃料棒を構成するとペレットの配列状態は、 中性子束の高い炉心中央部に核分裂生成ガス蓄積のための空間を作 ることが必要になって、中性子束の局部的増加、炉心体積の増加な ど核設計上好ましくない現象を呈する。本発明はこれを解決するも ので、原子炉炉心の不要な空間を可及的に小さく押えるようにした ものである。

図2はその実施態様を示すものであり、3および4はそれぞれ上 下セグメント、5はペレット、6および7は連結プラグで、プラグ 6孔にプラグの7突出部を嵌着(かんちゃく)することにより上下セ グメントをつないで燃料棒とする。そして、プラグ7には連結部材 の上下被覆管内空間を連通する貫通孔8を設ける。被覆管内に発生 した核分裂生成ガスの外部漏えいを避けるためそれぞれの係合部に は溶接9を施す。

このようにして燃料棒を構成することによって、下セグメントで 発生した核分裂生成ガスは上セグメントの上部空間に蓄積されるこ とになるから、下セグメントのために炉心中央に空間を設ける必要 がなくなる。したがって、燃料棒全長を短くすることができるから ひいては炉心体積の増加を防ぐとともに、中性子束の局部的増加を 防ぐことにもなる。 (高田 幸)

### 特許 第534788号 (特公昭43-15113号)

従来,漫画映画を作成するには,一つの動作に対して接近した画 を数多く手作業により描き,このようにして得られた多数の原図よ り作成されたフィルムを高速に動作させることによって,連続した 画像を作成する方法が取られており,その方法は原始的で膨大な労 力を必要とした。

可

動

画

像

— 40 —

この発明は漫画は一般に円・直線・放物線などの単純な特長部分 の集合体であり,かつその中での風景とか人間とかの変化動作は,各 図形の定数変更,座標変換などの操作をシーケンシャルに行なうこ とによって得られるものである点に着目してなされたものである。 図はその原理図を示すもので,この装置は基本図形発生装置,シ ーケンシャル制御装置,表示装置よりなる。基本図形発生装置は漫 画の基本形を発生する部分で,たとえば積分器,加算器,ポテンシ ョメータなどのアナログ演算要素より成り,シーケンシャル制御装 置は上記基本図形の変形,変更の制御を時間的にくぎって行なう部 分で,たとえば,上記制御に必要な操作量を記憶するディジタルメ モリと,これらの操作量を必要に応じて読出す機能と、それらの操 作量を基本図形発生装置に送って制御する機能とより成るものであ

### 三 浦 武 雄 • 津 田 順 司 • 岩 田 純 蔵

## 表 示 装 置

り、表示装置は出力される情報を表示する部分である。

この発明は,漫画映画のほかに,訓練用シミュレータの模擬視界 装置,PR用提示装置など利用できる広い応用分野を持っている。 (高崎)



